

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Наименование образовательной программы: Полупроводниковые материалы и структуры

Уровень образования: высшее образование - магистратура

Форма обучения: Очная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Микроэлектроника**

**Москва
2024**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик



| | |
|--|-------------------------------|
| Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | |
| Сведения о владельце ЦЭП МЭИ | |
| Владелец | Холодный Д.С. |
| Идентификатор | R0bac9dac-KholodnyDS-6393810d |

Д.С.
Холодный

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы



| | |
|--|-------------------------------|
| Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | |
| Сведения о владельце ЦЭП МЭИ | |
| Владелец | Холодный Д.С. |
| Идентификатор | R0bac9dac-KholodnyDS-6393810d |

Д.С.
Холодный

Заведующий
выпускающей
кафедрой



| | |
|--|--------------------------------|
| Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | |
| Сведения о владельце ЦЭП МЭИ | |
| Владелец | Славинский А.З. |
| Идентификатор | R99b3b9ab-SlavinskyAZ-c08f5214 |

А.З.
Славинский

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-2 Способен проводить исследования материалов и изделий микро- и наноэлектроники

ИД-2 Владеет навыками выбора теоретических и экспериментальных методов исследования материалов микро- и наноэлектроники

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Письменная работа

1. КМ-1 Тест «Основные типы межэлементной изоляции ИМС». (Контрольная работа)
2. КМ-2 Контрольная работа «Основы преобразования аналогового сигнала в цифровой». (Контрольная работа)
3. КМ-3 Тест «Особенности использования биполярных структур в цифровых ИМС». (Контрольная работа)
4. КМ-4 «Технологии создания МОП-структур с алюминиевым и поликристаллическим затворами: особенности конструкции, преимущества и недостатки. струкции, преимущества и недостатки». (Контрольная работа)
5. КМ-5 «Унипольярные приборы в цифровых ИМС» (Контрольная работа)

БРС дисциплины

1 семестр

| Раздел дисциплины | Веса контрольных мероприятий, % | | | | | |
|--|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Индекс КМ: КМ: | КМ- 1 | КМ- 2 | КМ- 3 | КМ- 4 | КМ- 5 |
| | Срок КМ: | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| (1) Роль микроэлектроники и наноэлектроники в научно-техническом прогрессе. Системы классификация изделий электронной техники. | | | | | | |
| (1) Роль микроэлектроники и наноэлектроники в научно-техническом прогрессе. Системы классификация изделий электронной техники. | + | | | | | |
| (2) Межэлементная изоляции в ИМС с применением обратно-смещенного р-п перехода, U- и V-образных канавок. Диэлектрическая и комбинированная изоляция. | | | | | | |
| (2) Межэлементная изоляции в ИМС с применением обратно-смещенного р-п перехода, U- и V-образных канавок. Диэлектрическая и комбинированная изоляция. | + | | | | | |
| (3) Создание межэлементной изоляции - особенности проведения технологических операций диффузии, литографии, газового, ионно-плазменного и фото- | | | | | | |

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| стимулированного травления. | | | | |
| (3) Создание межэлементной изоляции - особенности проведения технологических операций диффузии, литографии, газового, ионно-плазменного и фотостимулированного травления. | | + | + | |
| (4) Особенности применения биполярных структур в логических схемах: ТТЛ, ЭСЛ и И2Л | | | | |
| (4) Особенности применения биполярных структур в логических схемах: ТТЛ, ЭСЛ и И2Л | | + | + | |
| (5) Горизонтальный р-п-р транзистор, транзистор с барьером Шоттки. Интегральные диоды и стабилитроны. Пассивные элементы ИМС | | | | |
| (5) Горизонтальный р-п-р транзистор, транзистор с барьером Шоттки. Интегральные диоды и стабилитроны. Пассивные элементы ИМС | | | + | |
| (6) Преобразование аналогового сигнала в дискретный, метод импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) | | | | |
| (6) Преобразование аналогового сигнала в дискретный, метод импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) | | | + | |
| (7) Мультиплексирование каналов цифровой связи, синхронизация сетей. Коды цифровых линий связи. | | | | |
| (7) Мультиплексирование каналов цифровой связи, синхронизация сетей. Коды цифровых линий связи. | | | | + |
| (8) Унипольярные приборы. Расчет порогового напряжения, учет влияния различных факторов на его величину. | | | | |
| (8) Унипольярные приборы. Расчет порогового напряжения, учет влияния различных факторов на его величину. | | | | + |
| (9) МОП полевой транзистор с алюминиевым и поликремниевым затворами. Диффузионные МОП полевые транзисторы. | | | | |
| (9) МОП полевой транзистор с алюминиевым и поликремниевым затворами. Диффузионные МОП полевые транзисторы. | | | | + |
| (10) Комплементарные структуры, КМОП-инвертор. Структуры с управляющим р-п переходом. МЕП- и НЕМТ-структуры. | | | | |
| (10) Комплементарные структуры, КМОП-инвертор. Структуры с управляющим р-п переходом. МЕП- и НЕМТ-структуры. | | | | + |
| Вес КМ: | 20 | 20 | 20 | 20 |

\$Общая часть/Для промежуточной аттестации\$

БРС курсовой работы/проекта

1 семестр

| Раздел дисциплины | Веса контрольных мероприятий, % | | | | |
|-------------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| | Индекс КМ: | KM-1 | KM-2 | KM-3 | KM-4 |
| | Срок КМ: | 4 | 8 | 12 | 15 |

| | | | | |
|---------|----|----|----|----|
| 1 | + | | | |
| 2 | | + | | |
| 3 | | | + | |
| 4 | | | | + |
| Bec KM: | 25 | 25 | 25 | 25 |

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

| Индекс компетенции | Индикатор | Запланированные результаты обучения по дисциплине | Контрольная точка |
|--------------------|--|---|---|
| ПК-2 | ИД-2пк-2 навыками выбора теоретических и экспериментальных методов исследования материалов микро- и наноэлектроники | Владеет знать: уметь 4 назначение, принципы практического применения, конструктивные особенности биполярных и унипольярных приборов, используемых в качестве активных элементов современных СБИС и УБИС; особенности изготовления и применения комплементарных МОП и МДП структур, структур с управляющим р-п переходом, МЕП-структур, транзисторов с высокой подвижностью электронов (HEMT- приборов) особенности применения и конструктивно- технологические требований, | КМ-1 Тест «Основные типы межэлементной изоляции ИМС». (Контрольная работа) КМ-2 Контрольная работа «Основы преобразования аналогового сигнала в цифровой». (Контрольная работа) КМ-3 Тест «Особенности использования биполярных структур в цифровых ИМС». (Контрольная работа) КМ-4 «Технологии создания МОП-структур с алюминиевым и поликристаллическим затворами: особенности конструкции, преимущества и недостатки. струкции, преимущества и недостатки». (Контрольная работа) КМ-5 «Унипольярные приборы в цифровых ИМС» (Контрольная работа) |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>предъявляемых к приборам, предназначенных для обработки цифровых сигналов.</p> <p>Уметь:</p> <p>использовать справочную и специальную литературу для сбора и анализа данных.</p> <p>применять методы анализа для выбора адекватных конструктивно-технологические решения при создании приборов микро- и наноэлектроники;</p> <p>делать научно-обоснованные выводы по результатам выполненных исследований изделий микро- и наноэлектроники,</p> <p>использовать справочную и специальную литературу для сбора и анализа данных.</p> | |
|--|--|--|

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. КМ-1 Тест «Основные типы межэлементной изоляции ИМС».

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Тест «Основные типы межэлементной изоляции ИМС».

Краткое содержание задания:

КМ-1 Тест «Основные типы межэлементной изоляции ИМС».

Контрольные вопросы/задания:

| | |
|--|--|
| Знать: назначение, принципы практического применения, конструктивные особенности биполярных и униполярных приборов, используемых в качестве активных элементов современных СБИС и УБИС; | 1.КМ-1 знать 2 1 . На примере n-p-n транзистора в составе ИМС объясните назначение эпитаксиального слоя в межэлементной изоляции и последовательность технологических операций по его созданию. 2. На примере n-p-n транзистора в составе ИМС объясните назначение и последовательность технологических операций по созданию межэлементных изолирующих областей. Поясните основные требования, предъявляемые к легирующей примеси при ее выборе. |
| Знать: особенности изготовления и применения комплементарных МОП и МДП структур, структур с управляющим р-п переходом, МЕП-структур, транзисторов с высокой подвижностью электронов (HEMT- приборов) | 1.КМ-1 знать 1 1. Приведите определение интегральной микросхемы; объясните назначение межэлементной изоляции в ИМС, создаваемых на базе биполярных транзисторов. В чем заключаются основные преимущества использования транзисторов n-p-n типа по сравнению с транзисторами n-p-n типа в ИМС. 2. На примере n-p-n транзистора в составе ИМС объясните назначение скрытого слоя в межэлементной изоляции и последовательность технологических операций по его созданию. 2.КМ-1 знать 4 1. Совмещенная межэлементная изоляция в ИМС: поясните основные преимущества и недостатки ее применения. Объясните назначение и порядок выполнения основных технологических операций по созданию межэлементной изоляции по технологии «Изопланар». Приведите аргументы в пользу ее применения. 2. Структуры с изолирующими канавками: сравните преимущества и недостатки использования методов ионно-плазменного и фотостимулированного травления кремния. Приведите основные |

| | |
|--|--|
| | преимущества и недостатки использования метода щелевой изоляции. |
|--|--|

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задачи

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-2. Км-2 Контрольная работа «Основы преобразования аналогового сигнала в цифровой».

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольная работа «Основы преобразования аналогового сигнала в цифровой».

Краткое содержание задания:

Контрольная работа «Основы преобразования аналогового сигнала в цифровой».

Контрольные вопросы/задания:

| | |
|--|---|
| Знать: особенности применения и конструктивно-технологические требования, предъявляемых к приборам, предназначенных для обработки цифровых сигналов. | <p>1.КМ-2 знать 1 1. Приведите и поясните основные операции по преобразованию непрерывного аналогового сигнала в дискретную форму. Объясните термин «Частота дискретизации».</p> <p>2. Объясните основной вывод теоремы Котельникова об условиях сохранения информации при преобразовании аналогового сигнала в дискретный и восстановлении аналогового сигнала по дискретному после его передачи по каналу связи.</p> <p>2.КМ-2 знать 2.</p> <p>1. Объясните назначение и основные операции, выполняемые в методе импульсно-кодовой модуляции (ИКМ-преобразовании), которые применяются при преобразовании аналогового сигнала в цифровую форму.</p> <p>2. Объясните, с чем связана необходимость использования операции квантизации при ИКМ-</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>преобразовании. Поясните происхождение шума квантизации и меры, позволяющие уменьшить его.</p> <p>3.КМ-2 знать 3</p> <p>1. Объясните необходимость сжатия цифрового сигнала. Поясните, почему применяется нелинейный (логарифмический) закон компандирования.</p> <p>2. В чем заключается принцип мультиплексирования (уплотнения) каналов связи. Объясните работу принципиальной схемы уплотнения на примере 24-х независимых речевых каналов связи.</p> <p>4.КМ-2 знать 4</p> <p>1. Приведите и поясните определения «временной слот и кадр (фрейм)», применяемых при мультиплексировании каналов. Приведите и поясните структуру кадра цифрового сигнала низшего уровня DS-1. Поясните, в чем заключается принцип разделения каналов связи по времени при мультиплексировании (TDM).</p> <p>2. Объясните, как определяется скорость передачи информации (емкость информационного канала связи) на примере цифрового сигнала DS-1. Чем определяется эффективность канала при цифровой передаче? Приведите и объясните структуру кадра E1 Европейского стандарта передачи цифровой информации, его основные отличия от стандарта, принятого в странах Северной Америки и Канады.</p> |
|--|--|

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто, выбрано верное направление для решения задачи

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено в отведенное время

КМ-3. КМ-3 Тест «Особенности использования биполярных структур в цифровых ИМС».

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Тест «Особенности использования биполярных структур в цифровых ИМС».

Краткое содержание задания:

Тест «Особенности использования биполярных структур в цифровых ИМС».

Контрольные вопросы/задания:

| | |
|--|---|
| Знать: особенности применения и конструктивно-технологические требования, предъявляемых к приборам, предназначенных для обработки цифровых сигналов. | 1.КМ-3 знать 3 1. Интегральные диоды и стабилитроны. Особенности выбора варианта конструктивного исполнения по заданным характеристикам прибора. 2. Основные факторы, определяющие время задержки переключения биполярного транзистора в схеме инвертора. |
| Знать: уметь 4 | 1.КМ-3 знать 1. Работа ЭСЛ-инвертора (работа схемы «токового зеркала»). Критерии выбора величины опорного напряжения. Основные преимущества и недостатки практического использования ЭСЛ-логических схем. Работа схемы, реализующей логические функции ИЛИ-НЕ/ИЛИ. 2. Принципиальная и эквивалентная схема интегральной инжекционной логики, И2Л, построенной на паре $p-n-p$ и $n-p-n$ транзисторов. Преимущества и недостатки использования логических схем интегральной инжекционной логики. 2.КМ-3 знать 2 1. Конструктивные особенности базового инвертора И2Л, обеспечивающие высокую плотность интеграции элементов. Влияние топологии на максимальное быстродействие базовой структуры многоколлекторного И2Л вентиля. 2. Конструктивно-технологические особенности транзисторов $p-n-p$ типа, применяемых в ИМС. Транзисторы с диодом Шоттки: конструкция, принцип работы, основные области применения. |
| Уметь: делать научно-обоснованные выводы по результатам выполненных исследований изделий микро- и наноэлектроники, | 1.КМ-3 уметь 1 Рассчитать и построить передаточную характеристику инвертора на биполярном транзисторе в случае использования элементов схемы со следующими значениями: $R_b = 10 \text{ кОм}$, $R_k = 1 \text{ кОм}$, $E_k = 5 \text{ В}$, $\beta = 50$ 2.КМ-3 уметь 2 Рассчитать и построить передаточную характеристику инвертора на биполярном транзисторе в случае использования элементов схемы со следующими значениями: $R_b = 15 \text{ кОм}$, $R_k = 3 \text{ кОм}$, $E_k = 6 \text{ В}$, $\beta = 70$ 3.КМ-3 уметь 4 |

| | |
|--|---|
| | Рассчитать и построить передаточную характеристику инвертора на биполярном транзисторе в случае использования элементов схемы со следующими значениями: $R_b = 10 \text{ кОм}$, $R_k = 4 \text{ кОм}$, $E_k = 4,5 \text{ В}$, $\beta = 50$ |
|--|---|

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-4. КМ-4 «Технологии создания МОП-структур с алюминиевым и поликристаллическим затворами: особенности конструкции, преимущества и недостатки. струкции, преимущества и недостатки».

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: «Технологии создания МОП-структур с алюминиевым и поликристаллическим затворами: особенности конструкции, преимущества и недостатки».

Краткое содержание задания:

«Технологии создания МОП-структур с алюминиевым и поликристаллическим затворами: особенности конструкции, преимущества и недостатки».

Контрольные вопросы/задания:

| | |
|---|--|
| Уметь: использовать справочную и специальную литературу для сбора и анализа данных. | 1.КМ-4 уметь 1 Рассчитать напряжение $2U_f$, при котором в n-канальном МОП полевом транзисторе наступает режим сильной инверсии проводимости в канале . Степень легирования канала $N_a = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ 2.КМ-4 уметь 3 Рассчитать напряжение $2U_f$, при котором в p-канальном МОП полевом транзисторе наступает режим сильной инверсии проводимости в канале . Степень легирования канала $N_d = 8 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ 3.КМ-4 уметь 4 |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | Рассчитать емкость подзатворного диэлектрика МОП полевого транзистора. В качестве диэлектрика используется диоксид гафния, диэлектрическая проницаемость $\epsilon = 24$, толщина окисла составляет 80 нм. |
|--|---|

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-5. КМ-5 «Унипольярные приборы в цифровых ИМС»

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: «Унипольярные приборы в цифровых ИМС»

Краткое содержание задания:

«Унипольярные приборы в цифровых ИМС»

Контрольные вопросы/задания:

| | |
|---|--|
| Уметь: применять методы анализа для выбора адекватных конструктивно-технологические решений при создании приборов микро- и наноэлектроники; | <p>1.КМ-5 уметь 1 Рассчитать протяженность области пространственного в области канала МОП полевого транзистора при возникновении условия сильной инверсии ($2U_f = 0,72 V$), степень легирования р-подложки в области канала составляет $3 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ Считать, что диэлектрическая проницаемость кремния равна 12.</p> <p>2.КМ-5 уметь 2 Рассчитать плотность заряда ионизированной примеси в области ОПЗ п-канального МОП полевого транзистора при условии, что степень легирования подложки в области формирования канала $N_A = 5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, протяженность области пространственного заряда (при условии сильной инверсии проводимости ($2U_f = 0,82 V$) составляет w</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p>$= 3 \cdot 10^{-5}$ см.</p> <p>3.КМ-5 уметь 3</p> <p>Рассчитать протяженность области пространственного в области канала МОП полевого транзистора при возникновении условия сильной инверсии ($2U_f = 0,78 B$), степень легирования n-подложки в области канала составляет $5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$</p> <p>Считать, что диэлектрическая проницаемость кремния равна 12.</p> <p>4.КМ-5 уметь 4</p> <p>Рассчитать плотность заряда ионизированной примеси в области ОПЗ р-канального МОП полевого транзистора при условии, что степень легирования подложки в области формирования канала $N_d = 8 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$, протяженность области пространственного заряда [при условии сильной инверсии проводимости ($2U_f = 0,782 \text{ В}$)] составляет $w = 7 \cdot 10^{-5}$ см.</p> |
|--|---|

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1 семестр

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Пример билета

пример билета

Процедура проведения

по билетам

I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-2ПК-2 Владеет навыками выбора теоретических и экспериментальных методов исследования материалов микро- и наноэлектроники

Вопросы, задания

- 1.билет 1 вопрос 1
- 2.билет 2 вопрос 1
- 3.билет 3 вопрос 2
- 4.билет 4 вопрос 1
- 5.билет 5 вопрос 2
- 6.билет 6 вопрос 1
- 7.билет 7 вопрос 12
- 8.билет 8 вопрос 2
- 9.билет 9 вопрос 1
- 10.билет 10 вопрос 1

Материалы для проверки остаточных знаний

- 1.остаточные 1 вопрос 1

Ответы:

- 1 остаточные 1 вопрос 1 варианты 123

Верный ответ: 1 остаточные ответ 1

2. остаточные 2 вопрос 2

Ответы:

- остаточные 2 вопрос 2 варианты 123

Верный ответ: остаточные 2 ответ 1

- 3.остаточные 3 вопрос 3

Ответы:

- 3остаточные 3 вопрос 3 варианты 123

Верный ответ: остаточные ответ 3

- 4.остаточные 4 вопрос 4

Ответы:

- остаточные 4 вопрос 4 варианты 123

Верный ответ: 4остаточные ответ 4

- 5.остаточные 5 вопрос 5

Ответы:

- остаточные 5 вопрос 5 варианты 123

Верный ответ: остаточные ответ 5

6.остаточные 6 вопрос 6

Ответы:

остаточные 6 вопрос 6 варианты 123

Верный ответ: остаточные ответ 6

7.остаточные 7 вопрос 7

Ответы:

остаточные 7 вопрос 7 варианты 123

Верный ответ: остаточные ответ 7

8.остаточные8 вопрос 8

Ответы:

остаточные 7 вопрос 7 варианты 123

Верный ответ: остаточные ответ 8

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Для курсового проекта/работы:

1 семестр

Форма проведения: Защита КП/КР

I. Процедура защиты КП/КР

по презентации

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня

Оценка: 2

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

стандартная